

EDGE MIRROR

Silicon Polish



EDGE MIRROR

半導体デバイスの高集積化が進むにつれて、シリコンの研磨面はますますクリーン化が求められています。ウェーファの製造プロセスにおいて、ウェーファの搬送およびハンドリング時の発塵防止・端面強化策としてウェーファ端面を鏡面にする必要があります。EDGE MIRRORシリーズは、ウェーファ端面を鏡面に仕上げる専用のポリシング材です。コロイダルシリカをベースにし、特殊組成溶液に調製されており、高能率で研磨後の洗浄性にも優れています。

(発売元:スピードファム株式会社)

EDGE MIRROR

With the increasing integration of semiconductor devices, wafer surfaces must be cleaned more efficiently than ever. To prevent dusting due to transportation and handling, and reinforcement of the edge surface, mirror-finishing of the edge surface must be performed during the wafer manufacturing process. EDGE MIRROR high-efficiency polish was developed exclusively for mirror finishing of wafer edge surfaces. It is comprised of colloidal silica dispersed in a liquid composed of special ingredients, and is superior in terms of cleanability after polishing. (Sales Agent: SpeedFam Co.,Ltd. Japan)

EDGE MIRRORの代表的物性 Typical Physical Properties of EDGE MIRROR

項目 Item	製品名 Type	EDGE MIRROR IV	EDGE MIRROR V	EDGE MIRROR 6
主成分 Main component		SiO ₂ コロイダル (colloidal)	SiO ₂ コロイダル (colloidal)	SiO ₂ コロイダル (colloidal)
SiO ₂ 量 Content of SiO ₂ (%)		40	35	40
PH		11.5	10.0	10.2
比重 Specific gravity		1.28	1.23	1.28
平均粒子径 Average particle size (nm)		35	20	80
ウェーファの種類 Kind of wafer		ベアシリコン bare silicon	酸化膜(ベアシリコンも可) silicon oxide (also for bare silicon)	デバイス device
標準入数 Standard Net weight		18kg	20kg	20kg
ドラム Drum		240kg	240kg	—